



Laserschneiden chirurgischer Implantate

Die Lasertechnologie ermöglicht eine hochpräzise und effiziente Bearbeitung medizinischer Produkte. SITEC bietet seinen Kunden dafür umfassende Engineering-Kompetenz, langjährige Erfahrung in der Lasermaterialbearbeitung sowie der Herstellung von automatisierten Produktionssystemen unter Kenntnis der ISO 13485.

Verfahrensvorteile

- Qualitativ hervorragende Schneidkanten
- Gratfreies Laserschneiden von dünnen Blechen bis 4 mm
- Minimaler Verzug durch geringen Wärmeeintrag

Ihre SITEC-Lösung

Zum effizienten und flexiblen Laserschneiden unterschiedlicher chirurgischer Implantate bieten wir Ihnen eine standardisierte Laserschneidanlage der Baureihe LS an. Das Be- und Entladen der Laserschneidanlage erfolgt automatisch mittels Werkstückspeicher und ermöglicht eine autonome Prozesszeit von bis zu 15 Stunden. Einfach und schnell können unterschiedliche Produktdesigns Dank der Programmverwaltung gespeichert und bearbeitet werden. Mit einer Wiederholgenauigkeit von $\pm 2 \mu\text{m}$ und Positioniergenauigkeit von $\pm 10 \mu\text{m}$ der SITEC-Laserschneidanlage erhalten Sie höchste Prozesssicherheit in der Fertigung. Für den Prozess lassen sich unterschiedliche Laserquellen integrieren.

Serienfertigung

Alternativ bietet Ihnen SITEC eine Anlauf- oder Serienfertigung auf hauseigenen Anlagen in zertifizierter Qualität nach ISO 9001.



Laserschneidanlage für chirurgische Implantate

- Laserstandardanlage der Baureihe LS
- Manuelles Be- und Entladen des Magazins
- Autonome Prozesszeit bis zu 15 Stunden durch internes Handling
- Programmverwaltung
- Integrierte Prozess- und Qualitätsüberwachung
- SIEMENS Steuerung
- Geringer Flächenbedarf
- Kurze Lieferzeiten

Ihr SITEC-Ansprechpartner

Robert Marx
Technischer Vertrieb
Telefon: +49(0) 371.4708 393
sales@sitec-technology.de